证券代码:301361　证券简称:众智科技　公告编号:2026-006

郑州众智科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以116,336,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众智科技	股票代码	301361
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓艳峰	孙哲	
办公地址	郑州高新区雪梅街28号	郑州高新区雪梅街28号	
传真	0371-67992962	0371-67992962	
电话	0371-67988888	0371-67988888	
电子信箱	dyf@smartgen.cn	zz@smartgen.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事发电机组及发动机控制系统、新能源微电网控制系统、智能电网控制系统等自动化产品的研发、制造、销售和服务,致力成为相关领域全球领先的整体系统解决方案提供商。

根据现阶段业务特点和日常统计口径,公司产品主要分为控制器类(包括陆用/船用发电机组及发动机控制器、双/多电源自动切换控制器、工程机械控制器、EMS、BMS、DVR、PMS等)、组件类(包括电气控制柜、储能电池柜、蓄电池充电器、发动机加热器、PCS等)以及其他类(包括云监控模块、传感器模块、通信模块、电力保护模块、I/O扩展模块等)。

2025 年度报告摘要

根据下游终端设备类型和应用情况,公司产品主要作为主用/连续电源、备用电源、应急电源、调峰电源等内燃动力发电系统的关键配套,以及用户侧为主的分布式能源系统的重要构成,广泛适用于应急保障、消防抢险、矿山石油开采、基建、船舶、风电、岛屿、商业楼宇、工业园区、数据中心/智算中心、通信基站、电源车辆、轨道交通、医院、公共场馆、微电网、工商业储能等场景。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,319,804,494.98	1,206,428,992.47	9.49%	1,129,162,771.74
归属于上市公司股东的净资产	1,225,020,964.67	1,148,615,923.54	6.65%	1,082,856,922.65
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	289,939,964.36	238,765,372.47	21.43%	220,061,594.20
归属于上市公司股东的净利润	96,474,808.62	79,719,320.89	21.02%	73,168,808.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,091,799.04	65,948,262.01	32.06%	53,043,749.02
经营活动产生的现金流量净额	94,492,917.83	64,218,521.65	47.14%	49,564,298.24
基本每股收益(元/股)	0.83	0.69	20.29%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.69	20.29%	0.63
加权平均净资产收益率	8.10%	7.14%	0.96%	6.99%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,740,785.66	74,229,131.68	71,029,926.90	86,940,120.12
归属于上市公司股东的净利润	19,039,995.28	23,544,186.40	28,060,833.88	25,829,793.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,503,393.30	21,814,562.36	25,860,161.83	22,913,691.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,091,568.40	25,186,866.13	26,225,583.94	44,172,036.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,311	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0						
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
崔文峰	境内自然人	32.16%	37,418,000.00	37,418,000.00	不适用	0.00	
杨新征	境内自然人	28.01%	32,582,000.00	32,582,000.00	不适用	0.00	
杨露	境内自然人	8.60%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用	0.00	
崔博	境内自然人	4.30%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00	
郑州众智投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	1,783,400.00	892,000.00	不适用	0.00	
#余洋	境内自然人	0.28%	324,200.00	0.00	不适用	0.00	
#禹源	境内自然人	0.22%	251,000.00	0.00	不适用	0.00	
#王杰	境内自然人	0.18%	212,400.00	0.00	不适用	0.00	
#李卫锋	境内自然人	0.16%	189,000.00	0.00	不适用	0.00	
#胡标	境内自然人	0.15%	175,000.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,崔文峰、杨新征均为公司控股股东、实际控制人,并且互为一致行动人。杨露为杨新征之女,崔博为崔文峰之子。崔文峰、杨新征为郑州众智投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人,且崔文峰担任执行事务合伙人。上述其他股东中,公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

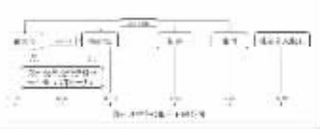
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,以及对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:301377　证券简称:鼎泰高科　公告编号:2026-009

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本410000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎泰高科	股票代码	301377
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周文英	吴宗泽	
办公地址	广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室	广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室	
传真	0769-89277198	0769-89277198	
电话	0769-89207168	0769-89207168	
电子信箱	BOD@dltechs.cn	BOD@dltechs.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及应用领域

公司产品涵盖四大类,包括精密刀具、研磨抛光材料、功能性膜材料及智能数控装备,主要应用于PCB、3C、精密机械制造等领域,并广泛服务于人工智能、具身机器人、低轨卫星、高端装备制造、智能汽车、半导体、消费电子、通信及工业控制等终端市场。主要产品示例如下:

(二)公司的行业地位

根据弗若斯特沙利文统计,按2024年销售量计算,公司PCB钻针全球市场份额达26.8%,排名行业第一。

(三)公司经营概述

2025 年度报告摘要

2025年,公司整体实现营业收入21.44亿元,同比增长35.70%;其中精密刀具实现营业收入17.40亿元,占营业收入比重81.17%;归属于上市公司股东的净利润4.34亿元,同比增长91.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元,同比增长102.53%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

(1)PCB行业需求爆发,公司迎来重大发展机遇

2025年,全球PCB行业正步入一轮由新兴技术应用驱动的增长周期,其核心动力来源于人工智能算力基础设施、高性能计算、智能电动汽车、新一代通信技术等关键前沿领域的爆发性需求。在算力基础设施领域,AI服务器的迅猛发展对高多层PCB构成显著拉动,推动PCB材料与工艺全面升级。为满足服务器、通信设备等终端应用对高速高频数据处理与稳定运行的需求,PCB需采用层数更多、布线更密、阻抗更低的设计,在有限空间内实现更高集成度。PCB刀具作为核心上游耗材,其技术升级与市场需求同步加速,迎来广阔的发展空间。

公司紧跟PCB基材硬化、板厚增加、布线密集化趋势,为满足其钻孔加工需求,公司联合上下游开展协同攻关,通过持续研发攻坚,凭借深厚的技术积淀与持续创新,公司在微小径钻针、高长径比钻针及高端涂层钻针领域取得系列技术突破,推动相应高端产品供应量与占比持续提升,同时已完成50倍以上高长径比钻针的技术储备,形成"量产一代、储备一代"的梯次布局,为抢占下一代市场高地筑牢根基。

报告期内,公司0.20mm及以下的微钻销量占比29.65%,涂层钻针的销量占比39.40%。

同时受益于PCB行业的产品结构性变化,在研磨抛光材料方面,公司积极开发超细不织布磨刷、高精细目数陶瓷磨刷等高端产品,精准匹配AI服务器、高端光模块及封装载板对精密加工的新需求。

报告期内,公司研磨抛光材料实现营业收入1.92亿元,同比增长27.61%。

(2)加速全球化进程,构筑竞争新优势

公司在稳固国内现有市场的基础上,重点开拓东南亚、日韩、欧美地区等海外市场,不断提升海外市场占有率。泰国子公司作为公司重要的海外生产基地,报告期内实现投产并产能稳步提升。为持续推进全球化战略,公司于报告期内成立了德国全资子公司,并于2025年8月完成了对德国MPK Kemmer公司的资产收购与整合,未来将依托德国当地的品牌、技术和市场资源,助力公司进一步提升研发实力和拓展销售渠道,全面提升全球影响力。

报告期内,公司境外营业收入1.96亿元,同比增长111.60%。

(3)高端装备迭代突破,筑牢可持续发展基石

在智能数控装备领域,公司以高端工业母机为核心突破方向,依托技术同源性,向高端精密磨床、具身机器人关节部件等战略性新兴领域延伸布局,目前已成功实现内外圆磨床、数控螺纹磨床等核心产品的研发突破,并重点攻坚高精度丝杠、灵巧手微传动机构等关键核心部件,技术布局持续深化。同时,行业首创的智能钻针库、全自动配针/退针机完成进一步迭代升级,凭借优异性能获得市场高度认可,产品交付能力实现跨越式提升,核心装备产品的市场竞争力与行业影响力进一步增强。

报告期内,公司智能数控装备实现营业收入7,678.92万元,较上年同比增长39.89%。

2025年7月,公司与中科硅纪(南京)机器人有限公司合资设立控股子公司广东鼎泰中科机器人有限公司,专注于具身机器人核心零部件研发与产化。2025年12月,公司设立了广东鼎泰智能技术有限公司,推动公司在机器人、智能制造及人工智能等新业务的专业化布局。未来,随着相关技术与产业布局逐步推进,公司有望在智能装备与具身机器人产业链中构建新的价值增长点。

(4)膜材料营收阶段性承压,供应链自主化夯实基础

在功能性膜材料领域,公司深耕消费电子与汽车两大核心赛道,聚焦反射式增量膜(DBEF)、偏光片AG膜等高端品类,构建起覆盖关键应用场景的膜材料产品矩阵。在车载光控膜方面,公司成功开发出专用胶水体系,在实现精准光线控制、消除倒影干扰的同时,满足车载显示严苛的1000小时老化测试要求及客户多样化的定制需求。目前,公司车载光控膜产品已通过多家主流车企认证,并在部分车型上实现批量稳定供应。

2025年,受上游关键原材料供应短缺影响,公司功能性膜材料业务营收阶段性承压。对此,公司迅速启动供应链优化与核心技术攻关:一方面全面推进主材自研自产战略,加快核心原材料国产化替代与自主量产进程,从源头减少外部依赖;另一方面持续推进设备智能化改造与工艺优化,实现提质增效,稳步提升产能利用率。随着上述改善措施落地见效,公司对上游供应的掌控能力显著增强,产能瓶颈逐步缓解,为下游订单的稳定交付提供有力保障。未来随着原材料自给率持续提升、产能利用率进一步爬坡,叠加车载光控膜等高端产品在更多车型上的渗透放量,公司功能性膜材料业务有望迎来营收修复与盈利能力改善。

报告期内,功能性膜材料实现营业收入7,368.55万元,较上年同期下降52.51%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,538,074,825.18	3,520,596,286.88	28.90%	3,179,443,666.55
归属于上市公司股东的净资产	2,648,272,894.46	2,476,792,851.01	6.92%	2,318,803,454.08
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,143,538,078.96	1,579,629,986.34	35.70%	1,320,224,629.77
归属于上市公司股东的净利润	433,634,347.56	226,870,061.03	91.14%	219,307,938.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,031,737.75	201,959,224.13	102.53%	175,988,071.25
经营活动产生的现金流量净额	290,851,781.26	273,194,717.93	6.46%	182,293,092.59
基本每股收益(元/股)	1.06	0.55	92.73%	0.53
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.55	92.73%	0.53
加权平均净资产收益率	16.53%	9.38%	7.15%	9.63%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,285,501.23	480,983,352.81	553,053,190.27	686,216,034.65
归属于上市公司股东的净利润	72,584,358.60	87,167,979.81	122,566,567.48	151,315,441.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,393,171.68	81,429,001.64	114,808,931.88	146,400,632.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,680,558.41	-20,717,140.27	51,408,141.03	268,841,338.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0						
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东太鼎控股有限公司	境内非国有法人	76.23%	312,552,000.00	312,552,000.00	不适用		
浙江太鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.73%	23,508,000.00	23,508,000.00	不适用		
泰州睿海电子产品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	4,571,508.00		不适用		
泰州睿鸿电子产品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	4,454,599.00		不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	3,029,291.00		不适用		
泰州睿和电子产品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	2,916,000.00	2,916,000.00	不适用		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,169,234.00		不适用		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,994,586.00		不适用		
交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,743,100.00		不适用		
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,237,235.00		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东太鼎控股有限公司为公司控股股东,王馨、王俊锋、王雪峰和林侠为公司实际控制人,其构成一致行动关系。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过广东太鼎控股有限公司间接持有公司76.23%的股份,通过浙江太鼎创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。林侠以普通合伙人的身份通过泰州睿和电子产品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与泰州睿和构成一致行动关系;王馨通过泰州睿海电子产品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;王俊锋通过泰州睿鸿电子产品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司筹划H股发行并在香港联交所上市。截至本公告披露日,公司已递交上市申请表格(A1),本次发行上市能否通过相关审议、备案及审核程序并最终实施,存在重大不确定性。

证券代码:300054　证券简称:鼎龙股份　公告编号:2026-013

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨平彩	黄云	
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司,并致力于成为全球领先的创新材料平台型公司,目前重点聚焦半导体创新材料领域中:半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。此外,公司在传统打印复印通用耗材业务领域进行了全产业链布局。

● 业务概要

(1)半导体业务

A.半导体制造用工艺材料-CMP制程工艺材料

CMP抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料,根据SEMI数据,CMP抛光材料在集成电路制造材料成本中占比7%,其中CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液合计占CMP抛光材料成本的85%以上。根据TECHCET预测显示,2029年全球半导体CMP抛光材料市场规模将超过50亿美元,2024-2029年复合增长率为8.6%。公司致力于为下游晶圆制造企业提供一站式 CMP 核心材料与整体解决方案,持续强化 CMP 环节的系统化产品结合能力、专业技术服务能力与综合方案解决能力,已成为国内首家、亦是唯一一家覆盖集成电路 CMP 全品类材料的综合解决方案供应商。

在CMP抛光垫产品方面,公司目前是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商,确立CMP抛光垫国产供应龙头地位,产品深度渗透国内主流晶圆厂客户,成为部分客户的第一供应商,被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商。

在CMP抛光液产品方面,公司开展全制程及多品类CMP抛光液产品布局,搭配自主研磨粒子在客户端持续推广、导入,部分品类进入快速放量阶段。

在清洗液产品方面,公司铜制程CMP后清洗液持续稳定获得订单,其他制程抛光后清洗液产品结合整体业务战略安排进行开发验证,持续完善业务布局。

图2.2.1:鼎龙CMP制程工艺材料产品简介

B.半导体制造用一高端晶圆光刻胶

晶圆光刻胶是半导体光刻工艺中的关键材料,目前国内在先进的KrF、ArF、EUV光刻胶领域尚未实现大规模量产,而KrF、ArF光刻胶因其覆盖了从0.25μm到7nm的主要半导体先进制造工艺,是现阶段迫切需要实现技术突破的半导体关键材料,具有十分重要的战略意义和经济价值。根据弗若斯特沙利文市场研究,预计2028年中国半导体光刻胶市场市场规模将达到150.3亿元,2023-2028年的年复合增长率18.5%,高于全球半导体光刻胶市场规模增速,其中:KrF光刻胶市场规模将达到49.3亿元、ArF光刻胶市场规模将达到57.6亿元。

图2.2.2:境内2019-2028年半导体光刻胶市场规模分析,来源Frost & Sullivan

公司着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关,实现高端光刻材料产业化,推动高端光刻胶国内自主化供应进程。公司自2022年5月布局高端晶圆光刻胶业务,截至报告期,已实现从产品研发、小中试线建设、订单获取,到建成国内首条"有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配"全流程的高端晶圆光刻胶量产线,并完成产品稳定批量供应,成为国内该领域推进速度最快、技术水平对标国际一流、ArF和KrF光刻胶产品在国内实现"全制程"与"全尺寸"覆盖的高端晶圆光刻胶企业。

图2.2.3:鼎龙高端晶圆光刻胶产品简介

C.半导体显示材料

公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心材料布局,推出黄色聚酰亚胺浆料YPI、光敏聚酰亚胺浆料PSPI、薄膜封装材料TFE-INK等系列产品。据群智咨询(Sigmaintell)2026年2月发布数据,2025年全球柔性OLED智能手机面板出货量达6.9亿片,同比增长9.6%,中国厂商在柔性OLED市场份额已达57.9%。目前,公司YPI、PSPI、TFE-INK产品已在客户端规模销售,并已成为国内部分主流面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商,确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位。同时,公司凭借在OLED显示材料领域多年的积累,对标国际一流共同探索未来显示技术工艺路线及相应材料应用方向,努力成为新型显示前沿技术的创新材料支持商。

图2.2.4:鼎龙半导体显示材料产品简介

D.半导体先进封装材料

先进封装作为摩尔定律逼近物理极限背景下的核心突破路径,凭借异构集成、性能倍增的技术优势,已成为半导体产业持续升级的关键赛道。在全球产业竞争格局深度调整的背景下,先进封装更成为支撑国内半导体产业突破发展瓶颈、实现技术迭代的重要抓手。

公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局,目前重点开发半导体封装PI、临时键合胶等产品,快速推动先进封装材料项目的产品开发验证、市场推广,进一步巩固产业竞争力,助力半导体封装产业实现高质量发展。

图2.2.5:鼎龙半导体先进封装材料产品简介

E.集成电路芯片设计和应用

集成电路芯片设计是集成电路产业链上游的重要环节。公司子公司旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的企业,深耕打印复印耗材芯片细分领域 18 年,拥有自主独立知识产权产品,国内领先的公司自有芯片分析实验室,是国家高新技术企业,纳入国家发改委重点布局软件企业,是国家级专精特新小巨人企业。公司稳步完善芯片产品矩阵,同时针对芯片制造环节部分关键技术的问题,积极在半导体零部件控制系统产品领域进行布局和探索。

图2.2.6:鼎龙集成电路芯片产品简介

(2)打印复印通用耗材业务

打印复印通用耗材行业市场竞争模式较为成熟,通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大、产品价低质优的头部企业。公司以全产业链运营为发展思路,上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料,下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品,实现产业上下游的联动,支持公司的竞争优势地位。目前,公司是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。彩色碳粉领域,公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺,且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业;再生墨盒领域,子公司绩迅科技是国家工信部再制造墨盒产品认定的首家企业,是国家级专精特新小巨人企业。

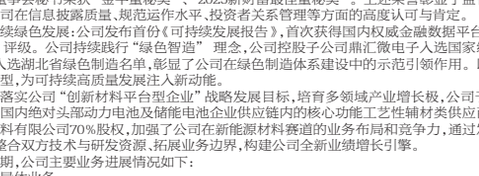


图2.2.7:鼎龙打印复印通用耗材产品简介

● 经营情况与主要业绩驱动因素

鼎龙股份致力于成为全球领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司。在材料创新平台的搭建过程中,鼎龙一直坚持"四个同步":一是坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步;二是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步;三是坚持材料技术创新与人才团队培养同步;四是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步,以此引领企业持续创新发展。

2025年度,公司实现营业收入36.6亿元,同比增长9.66%;实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元,同比增长38.32%。其中,今年第四季度:实现营业收入9.62亿元;实现归属于上市公司股东的净利润2.01亿元,同比增长39.07%。经营业绩同比变动的原因主要系:

①半导体业务实现营收与利润双增长,经营质效稳步提升。报告期内,公司半导体业务延续收入、利润持续增长的良好态势。其中,CMP抛光材料、半导体显示材料在国内主流晶圆制造企业及显示面板厂商的客户渗透力度持续加大,半导体先进封装材料新品逐步实现规模化销售,共同驱动半导体业务收入稳步增长。同时,依托产能释放带来的规模效应、供应链体系持续优化及生产工艺不断改良,半导体业务保持较强盈利能力,其归属于母公司所有者的净利润规模同比实现大幅增长。

②公司全面推进降本控费与精益运营,整体运营效率显著改善。报告期内,公司紧密结合业务实际,围绕生产工艺、能源动力、集中采购、设备维保等关键环节实施全流程精细化管控,在保障经营效益、提升运营质量的前提下有效降低运营成本,进一步增强公司整体盈利能力。

③报告期内,因实施上市公司股权激励计划,计提股份支付费用4,552万元,从而影响公司归母净利润4,203万元。

④报告期内,高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务尚属于市场开拓及放量初期,尚未盈利,且持续投入,一定程度上影响了本报告期的归母净利润水平。

本报告期,公司经营性现金流量净额为11.56亿元,同比增长39.64%,现金流情况稳健,为公司各项业务的发展、投入提供了有力支持。公司维持较高研发投入力度,报告期内研发投入金额5.19亿元,较上年同期增长12.32%,占营业收入的比例为14.19%,为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实的支撑,创新材料与技术的平台化布局持续完善,综合创新能力得到进一步巩固与提升。

本报告期,公司在行业内及资本市场获评多项荣誉:

①行业内所获荣誉:旗下控股子公司一柔显科技成为旗下第2家入选国家专精特新重点"小巨人"企业的公司,鼎泽新材料成为旗下第5家入选国家专精特新"小巨人"企业的公司;鼎汇微电子、柔显科技分别获得多家国内主流晶圆厂客户、主流面板厂客户的合作奖项;"OLED 显示屏用无氟光敏聚酰亚胺材料" 荣获中国电子材料行业协会一创新突破奖等。上述荣誉展现了公司半导体创新材料平台型企业的综合实力、行业影响力及产品竞争力。

②资本市场端所获荣誉:公司荣获深交所信息披露A级评级,连续3年获得A级评价;入选"创业板上市公司价值50强"、上海证券报"金质量-科技创新奖"、中上协"ESG可持续发展优秀实践案例"等称号;公司董事会秘书荣获"金牛董秘奖"、"2025新财富最佳董秘奖"。上述荣誉彰显了监管机构和资本市场对公司在信息披露质量、规范运作水平、投资者关系管理等方面的高度认可与肯定。

③可持续绿色发展:公司发布首份《可持续发展报告》,首次获得国内权威金融数据平台万得Wind的ESG"A"评级。公司持续践行"绿色智造" 理念,公司控股子公司鼎汇微电子入选国家绿色制造名单,本公司入选湖北省绿色制造名单,彰显了公司在绿色制造体系建设中的示范引领作用。以科技创新驱动绿色转型,为可持续高质量发展注入新动能。

为持续落实公司"创新材料平台型企业"战略发展目标,培育多领域产业增长极,公司于2026年第一季度收购国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材类供应商一深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,加强了公司在新能源材料赛道的业务布局和竞争力,通过发挥公司平台化优势、整合双方技术与研发资源、拓展业务边界,构建公司全新业绩增长引擎。

本报告期,公司主要业务进展情况如下:

(1)半导体业务

2025年,公司半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)实现主营业务收入20.86亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长37.27%,占公司总营业收入57%,标志着公司半导体业务成为公司核心盈利支柱与战略发展主引擎,进一步实现从产品布局到规模领跑的跨越,业务结构转型升级取得显著经营成效。各细分业务具体进展如下:

A.CMP抛光垫业务:2025年,累计实现产品销售收入10.91亿元,同比增长52.34%;其中,第四季度实现产品销售收入2.96亿元,同比增长53.4%。公司于2025年首次实现抛光垫单月销量破4万片的历史新高,CMP抛光垫国产供应龙头地位进一步夯实。

抛光硬垫方面,公司持续推进产品迭代升级,全面适配下游客户多元化、高端化需求,产品技术节点持续提升。客户拓展成效显著,海外市场布局有序推进,已与多家海外客户达成合作意向并稳步推进产品导入;本土外资晶圆厂客户市场推广也在持续进行中。产能建设方面,武汉本部抛光硬垫产线产能至2026年一季度末已达到月产5万片左右(即年产约60万片),产能利用率持续提升。

抛光软垫方面,公司产品矩阵进一步丰富,软垫及缓冲垫持续稳定放量供应,业内知名度持续提升,潜江工厂盈利水平稳步优化;公司积极拓展大硅片、第三代半导体、先进封装等新领域市场,成功切入并获取订单,产品应用场景持续拓宽。公司正在建设的光电半导体材料研发制造中心项目,包含40万片大硅片抛光垫等产能,项目投产后,将进一步增强公司在相关领域的综合竞争力。

原材料方面,公司持续强化核心原材料自主制备能力,保障供应链稳定高效。其中,预聚体持续实现稳定供应;微球产品实现关键突破,仙桃园区微球产线已正式量产,生产良率处于较高水平。公司正在建设的光电半导体材料研发制造中心项目,配套了年产4,000吨预聚体、200 吨微球发泡等相关产能,可进一步满足公司未来抛光垫产品生产需求。

生产运营方面,公司持续推进产线智能化升级,对部分产线进行AI功能改造,通过智能化技术赋能生产全流程,有效提升生产效率、优化生产管控水平,进一步优化生产成本,助力公司实现精益运营,为产品产能释放、良率提升提供了有力支撑。

B.CMP抛光液、清洗液业务:2025年,累计实现产品销售收入2.94亿元,同比增长36.84%;其中,第四季度实现产品销售收入9,132万元,同比增长21.72%。

CMP抛光液产品中铜及铜阻挡层、金